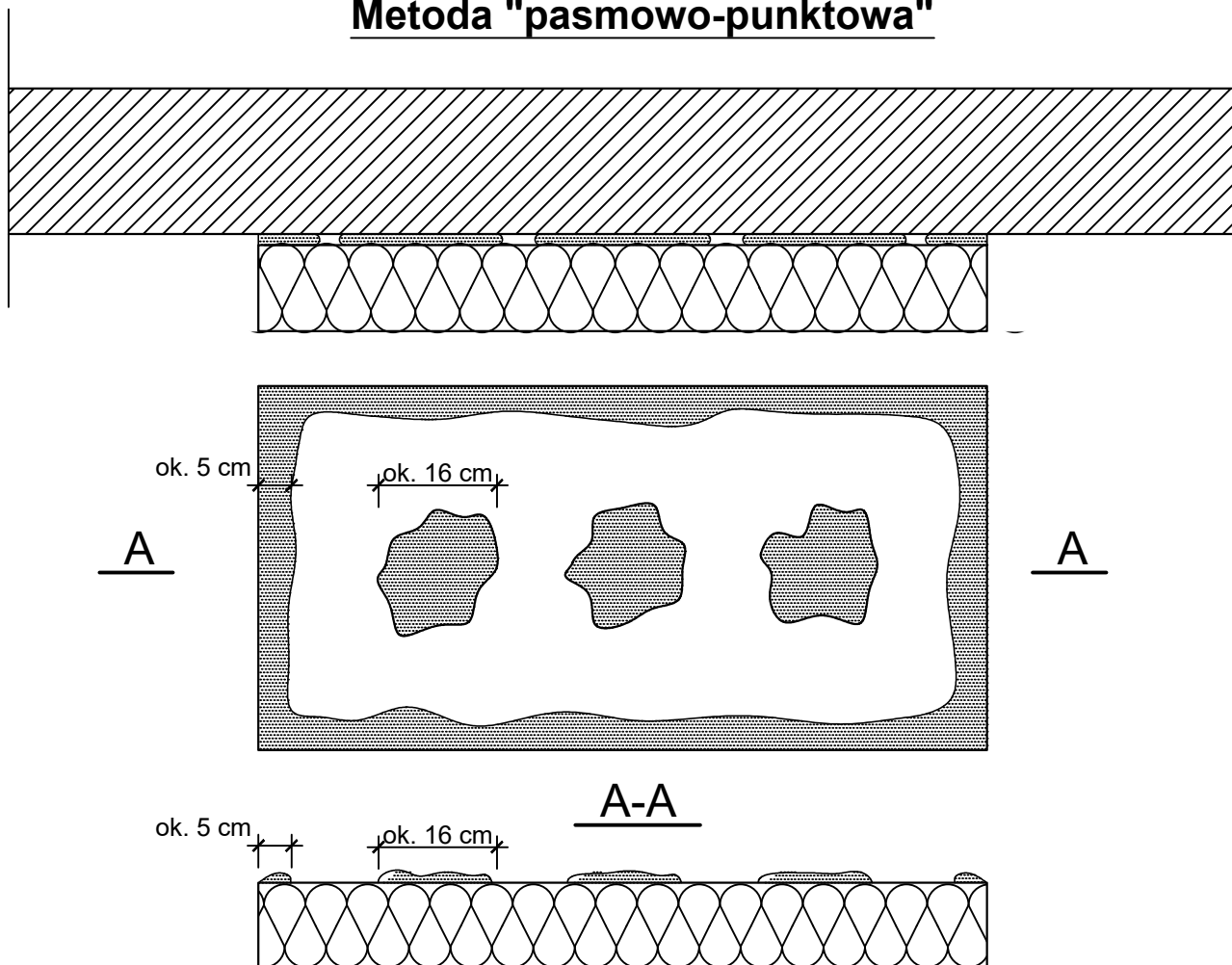


SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

STYROPIAN

Metoda "pasmowo-punktowa"



Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płycie nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej używa się:

- fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych,
- zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Użyte produkty należy każdorazowo przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

EKOPROBUD <small>Firma projektowo-wykonawcza</small>		EkoProBud Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65 tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.com.pl	
ADRES INWESTYCJI:		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71 41-949 Piekary Śląskie	
TYTUŁ:		PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 71 W PIEKARACH ŚLĄSKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZĄCYMI	
TYTUŁ RYSUNKU:		SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ	
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87	PODPIS:	04-2023
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK	PODPIS:	SKALA: 1:10
OPRACOWANIE:	mgr inż. N. Kajtoch	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	18